



**Powerlink Microelectronics**

# PL51WT103

**ADC 型/电容触摸型  
低功耗高性能 2.4GHz RF  
无线射频收发 SOC**

## 芯片概述:

PL51WT103 是一款工作在 2.4~2.4835GHz 世界通用 ISM 频段的 ADC 型/电容触摸型的低功耗高性能 2.4GHz RF 无线射频收发 SOC。

内部集成了 2.4GHz RF 收发模块、单指令周期 1T 的增强型 ET8051 内核、16K 字节的在芯片可编程 Flash 程序存储器、256 字节 EEPROM 数据存储器、256 字节的 IRAM、1K 字节的 XRAM, 最多 15 个双向通用 I/O 口等。可配置程序区、数据区读出控制权限, 同时程序区代码加密扰码存储, 高安全级别地保护用户程序及数据。

该单芯片无线收发器集成包括: 频率综合器、功率放大器、晶体振荡器、调制解调器等。

输出功率、信道选择与协议等可以通过 SPI 接口进行灵活配置。

支持跳频以及接收强度检测等功能, 抗干扰性能强, 可以适应各种复杂的环境并达到优异的性能。

内置地址及 FEC、CRC 校验功能。

内置自动应答及自动重发功能。

芯片发射功率最大可以达到 5.5dBm, 接收灵敏度可以达到 -88dBm。

内置电源管理功能, 掉电模式和待机模式下待机电流可以减小到接近 3uA。

内置晶振两端电阻 (680K)、电容 (2\*15pF)。

内置 ANT、ANTB 天线端 10K 下拉电阻。

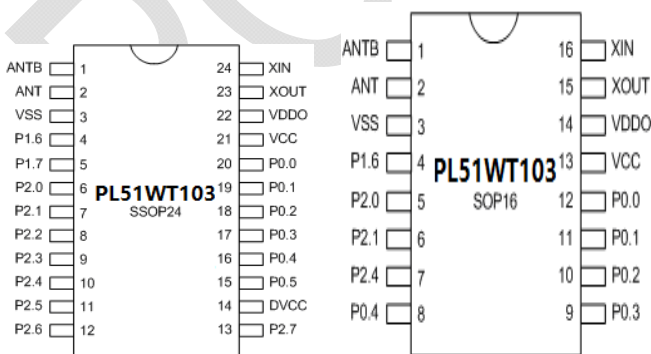
聚元微提供在线调试烧写器与脱机批量烧录器。

PL51WT103 支持 UART/SPI/I2C 接口。

## 主要特点:

- 2.4GHz RF无线射频收发SOC
- 1T增强型ET8051内核
- 内置16K字节Flash
- 内置256字节真EEPROM
- 无线速率: 1Mbps
- 内置硬件链路层
- 内置接收强度检测电路
- 支持自动应答及自动重发功能
- 内置地址及FEC、CRC校验功能
- 极短的信道切换时间, 可用于跳频
- 内置12MHz RF晶振两端电阻、电容
- 内置ANT、ANTB天线端10K下拉电阻
- 使用微带线电感和双层PCB板
- 集成8+4 (移位) 电容触摸按键
- 工作频率@工作电压:  
~12MHz@2.4~3.6V
- 工作温度: -25℃~+105℃
- 最多15个双向通用I/O口
- 3个16位定时器/计数器
- 6路12位PWM: PWM0/1/2/3/4/5
- 支持UART/SPI/I2C接口
- 集成8通道11位ADC
- 支持在芯片编程功能
- SOP16、TSSOP20、SSOP24封装
- Flash程序区: 40年、10万次
- EEPROM数据区: 40年, 50万次

## 管脚分布图:



## 典型应用:

- 智能家居, 无线智能LED调光调色
- 鼠标、键盘和游戏控制器
- 遥控装置
- 电磁炉、微波炉、洗衣机、洗碗机、冰箱、空调、玩具等



## 产品选型

产品名	封装	程序 Flash	数据 EEPROM	RAM	Timer	PWM	Freq @Voltage	I/O	接口 UART/SPI/I2C			ACMP	T.S.	Touch Key <sup>*1</sup> /Wakeup(Max)	ADC
PL51WT103B24	SSOP24	16K	256	256+1K	3	6+1	~12M@2.4~3.6V	16	1	1	1	1	1	8+4 <sup>*3</sup> /10	8
PL51WT103T20	TSSOP20	16K	256	256+1K	3	6+1		13	1	1	1	1	1	6+4 <sup>*3</sup> /5+4	6
PL51WT103S16	SOP16	16K	256	256+1K	3	4+1		9	1	1	1	1	1	4+4 <sup>*2</sup> /3+4	4

注: \*1: 电容触摸按键检测功能和 ADC 功能不能同时使用, 但可以分时使用;

\*2: 移位的触控按键<15:12>具有唤醒功能;

\*3: 移位的触控按键<15:12>和原始端口的可以分时工作, 但仅其中一组<15:12>具有唤醒功能;

\*4: ACMP 比较器源, 仅在 CMP2 和 INTVREF (1.2V)之间;

# 目录

芯片概述:	1
产品选型	2
1 概述	4
2 特性	5
3 快速参考数据	6
4 引脚配置	7
4.1 引脚图	7
4.2 引脚说明	8
5 模块框图	10
6 极限参数	10
7 电气特性	11
7.1 射频RF电气特性	11
7.2 直流电气特性	11
7.3 交流电气特性	12
7.3.1 外部时钟特性	12
7.3.2 内部RC振荡特性	12
7.3.3 晶体振荡器/陶瓷振荡器特性	13
8 内部RF接口	14
8.1 SPI接口说明	14
8.2 SPI命令格式	14
9 存储器	16
9.1 存储器加密	16
9.2 寄存器定义	16
9.2.1 EEPROM控制寄存器-EECON	16
10 ICP (在线编程)	17
11 ICD(在线调试)	18
12 配置选项	19
13 MCU核详细说明	20
14 RF模块控制寄存器	20
15 典型应用	21
15.1 智能照明: RGB七彩+冷暖双色	21
16 封装尺寸	22
16.1 SSOP24 封装	22
16.2 TSSOP20 封装	23
16.3 SOP16 封装	24
17 订购信息	25
18 文档修改记录	25
19 注意事项	25

# 1 概述

PL51WT103 是一款工作在 2.4~2.4835GHz 世界通用 ISM 频段的 ADC 型/电容触模型的低功耗高性能 2.4GHz RF 无线射频收发 SOC。

内部集成了 2.4GHz RF 收发模块、单指令周期 1T 的增强型 ET8051 内核、16K 字节的在芯片可编程 Flash 程序存储器、256 字节 EEPROM 数据存储器、256 字节的 IRAM、1K 字节的 XRAM、最多 15 个双向通用 I/O 口等。

内部完全集成了电容触摸按键功能，应用时无需增加外接元件。该器件采用特殊的算法减少触摸动作的误判，提高触摸按键在恶劣环境下应用的可靠性。支持自动校准配置，触摸按键可以工作在更宽的动态电容范围，同时降低功耗、提高识别的灵敏度。在触摸按键产品应用开发方面，该器件为用户提供简单、可靠并易于实现的方法。

在线烧录 ICP 支持用户升级程序和数据：可配置程序区、数据区读出控制权限，同时程序区代码加密扰码存储，高安全级别地保护用户程序及数据。

该单芯片无线收发器集成包括：频率综合器、功率放大器、晶体振荡器、调制解调器等。

输出功率、信道选择与协议等可以通过 SPI 接口进行灵活配置。

支持跳频以及接收强度检测等功能，抗干扰性能强，可以适应各种复杂的环境并达到优异的性能。

内置地址及 FEC、CRC 校验功能。

内置自动应答及自动重发功能。

芯片发射功率最大可以达到 5.5dBm，接收灵敏度可以达到 -88dBm。

内置晶振两端电阻 (680K)、电容 (2\*15pF)。

内置 ANT、ANTB 天线端 10K 下拉电阻。

器件内部集成高频、低频振荡器，具有在不同工作模式之间动态切换的能力，从而优化微控制器的操作并且减少功耗。

器件内建完整的 UART、I2C 及 SPI 接口，为设计者提供一个与外部硬件通信的接口。外加优秀的抗干扰和 ESD 保护，确保单片机能够在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。在存储器方面，除了 Flash 程序存储器，还包含一个 RAM 数据存储器 and EEPROM 数据存储器。

为了提高可靠性和降低成本，器件内置可靠的看门狗定时器 (WDT)、低电压检测 (LPD)、低电压复位 (LVR) 功能模块。为了减少功耗，器件可以工作在三种低功耗模式下：绿色 IDLE 模式、停止 STOP 模式和睡眠 SLEEP 模式；在低功耗模式下，支持键盘快速唤醒。

为了方便用户使用，POWERLINK 提供在线调试烧录器与脱机批量烧录器。

该系列的无线触摸按键微控制器可以广泛的应用于各种产品中，例如无线鼠标、无线键盘、游戏控制、射频远程控制，电磁炉、微波炉、洗衣机、烘干机等家用电器。

## 2 特性

### 射频RF

- 低功耗高性能2.4GHz RF无线射频收发SOC
- 无线速率：1Mbps
- 内置硬件链路层
- 内置接收强度检测电路
- 支持自动应答及自动重发功能
- 内置地址及FEC、CRC校验功能
- 极短的信道切换时间，可用于跳频
- 内置12MHz RF晶振两端电阻、电容
- 内置ANT、ANTB天线端10K下拉电阻
- 使用微带线电感和双层PCB板

### 基本特性

- 单周期8位ET8051 CPU内核
- 集成8+4（移位）触摸按键功能，无需增加外接元件
- 工作频率@工作电压：~12MHz@2.4~3.6V
- 工作频率：~12MHz
- 工作温度：-25℃ ~ +105℃
- 振荡器类型
  - ◇ 外部晶体振荡器：400KHz ~ 12MHz
  - ◇ 内部 RC 振荡器：4/8/12MHz 和 32KHz
  - ◇ 外部时钟：400KHz ~ 12MHz
- 多达15个双向通用I/O口
  - ◇ 仅作为输入端，具有上拉电阻
  - ◇ 推挽输出驱动能力：10mA (@3V, 总电流 <100mA)

### 周边特性

- 16个中断源具有4个中断优先级
  - ◇ 2个外部中断：INT0B 和 INT1B
  - ◇ T0&T1 溢出中断
  - ◇ T2 溢出、重载、比较/捕获中断
  - ◇ UART0、UART1 收发中断
  - ◇ EEPROM 写结束中断
  - ◇ 模拟比较器中断
  - ◇ 键盘中断
  - ◇ 触摸按键中断
  - ◇ SPI 中断
  - ◇ I2C 中断
  - ◇ ADC 转换结束中断
  - ◇ LPD 中断
- 支持上电复位、低电压复位、低电压检测
- 8个可配置的低电压复位阈值电平
  - ◇ 1.2/1.5/1.8/2.1/2.4/2.7/3.7/4.3V
- 8个可配置的低电压检测阈值电平
  - ◇ 1.2/1.5/1.8/2.1/2.4/2.7/3.7/4.3V
- 寄存器定时访问（TA）保护
- 可编程系统时钟
- 多种工作模式：正常、空闲、停止、睡眠
- 16位定时器/计数器
  - ◇ 与 80C51 类似的 Timer 0 & 1
  - ◇ 与 8052 类似的 Timer 2，具有比较捕获单元
- 6个12位的PWM：PWM0/1/2/3/4/5
  - ◇ PWM0/3 共用 1 组周期寄存器和控制寄存器
  - ◇ PWM1/4 共用 1 组周期寄存器和控制寄存器
  - ◇ PWM2/5 共用 1 组周期寄存器和控制寄存器

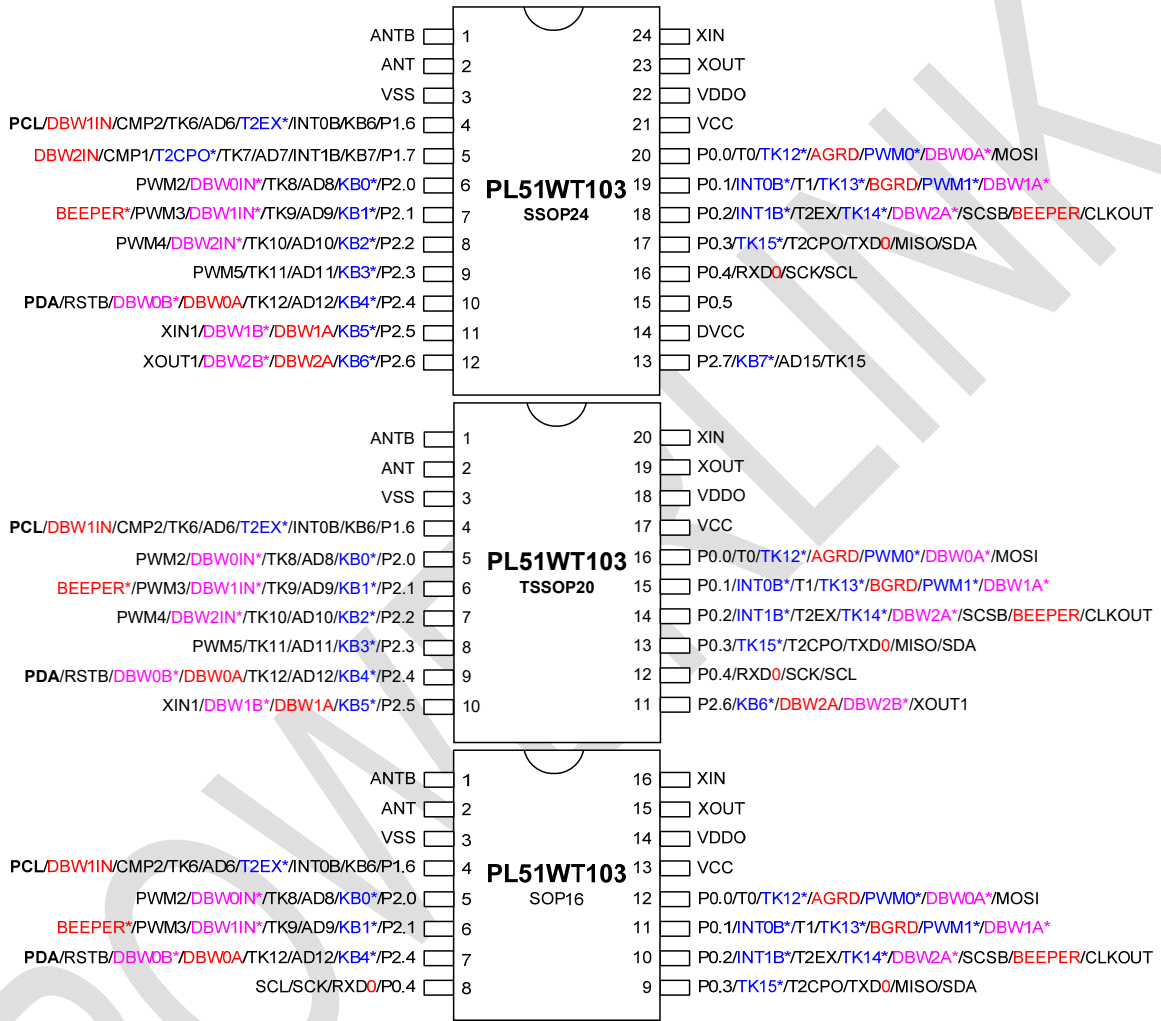
- ◇ 4种输出模式：标准、中心对齐、寄存器匹配时电平置1和翻转
- 3路死区波形发生器DBW
  - ◇ 上升沿、下降沿死区控制
  - ◇ 多个信号源选择
- BEEPER: 1/2/4 KHz
- 看门狗定时器：具有可配置预分频系数
- UART0/UART1/SPI/I2C接口
- ADC
- ✚ 存储器
  - 16K字节程序区Flash
  - 256字节数据区EEPROM（支持字节/页操作，64字节/页）
  - 256字节内置IRAM
  - 1K字节内置XRAM
- ◇ 11位
- ◇ 高达8通道
- ◇ 支持外部输入参考电压
- 模拟比较器（ACMP）
- 支持在线编程（ICP）
- 支持在线调试（ICD）
- ESD: 大于2KV(HBM)
- EFT: 大于4KV
- 封装类型：SOP16, SOP20/24
- 存储器编程权限控制
- 烧录次数：在25℃的条件下，Flash可以重复烧写10万次，EEPROM可以重复烧写50万次
- 数据可保存时间：在25℃的条件下，数据可以保存40年

### 3 快速参考数据

参数	值	单位
最小工作电压	2.4	V
最大输出功率	5.5	dBm
数据速率	1	Mbps
工作电流 (0dBm) @发送模式	16	mA
工作电流 @接收模式	17	mA
工作温度范围	-25 to +105	°C
接收灵敏度	-88	dBm
RF 晶振频率	12	MHz
CPU 内核内部 RC 频率	4/8/12	MHz
CPU 内核内部 12MHz RC 精度 @ 25°C	±2	%
静态电流@睡眠模式	3	uA

## 4 引脚配置

### 4.1 引脚图



注:

- 1) 引脚外侧的功能优先级高，引脚内侧的功能优先级低。如果某个引脚的高优先级的功能使能，那么该引脚低优先级的功能即使使能也无效。
- 2) 图中标示蓝色并且用\*标注的引脚，只有设置了特殊功能寄存器“PSFT0~1”中对应的控制位才使能该引脚功能。
- 3) 特别注意：此芯片中寄存器 `AUXCON.s003_sopt` 不可配置为 1。
- 4) 对于未使用或未引出的管脚，建议配置为输入上拉，或配置为输出固定电平。

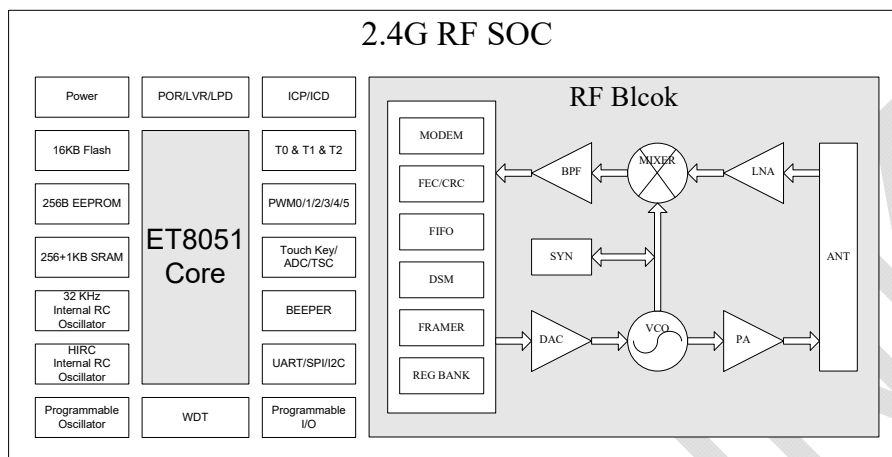
## 4.2 引脚说明

类别	符号	类型	描述
Power	VCC	电源	电源 (2.4~3.6V)
	VSS	电源	地 (0V)
	DVCC	电源	电源 (2.4~3.6V)
	DVSS	电源	地 (0V)
	VDDO	电源	1.8V电源, LDO输出, 外接电容
RF Block	ANTB	RF	天线
	ANT	RF	天线
	XIN	模拟输入	12MHz RF晶振输入
	XOUT	模拟输出	12MHz RF晶振输出
RF Block Interface	P1.0	数字输入	内部RF模块接口SPI.SDO输出
	P1.1	数字输出	内部RF模块接口SPI.SDI输入
	P1.2	数字输出	内部RF模块接口SPI.SCK输入
	P1.3	数字输出	内部RF模块接口SPI.SCSB输入
	P1.4	数字输入	内部RF模块接口FIFO状态指示位输出
	P1.5	数字输出	内部RF模块接口RSTB输入
Ext Reset	RSTB	数字输入	CPU核RESET输入, 低电平有效
Clock	XIN1	模拟输入	CPU核晶振输入
	XOUT1	模拟输出	CPU核晶振输出
	CLKOUT	数字输出	CPU核内部时钟输出
UART	RXD0	数字输入	串口0接收端
	TXD0	数字输出	串口0发送端
SPI	SCSB	数字输入	SPI选择信号, 低电平有效, 作为从SPI的输入信号
	SCK	数字输入输出	SPI时钟
	MISO	数字输入输出	SPI主输入从输出
	MOSI	数字输入输出	SPI主输出从输入
I2C	SCL	数字输入输出	I2C时钟
	SDA	数字输入输出	I2C数据I/O
Timer0	T0	数字输入	定时器0输入
Timer1	T1	数字输入	定时器1输入



类别	符号	类型	描述
Timer2	T2 EX	数字输入	定时器2外部重载或门控输入
	T2CPO	数字输出	定时器2比较输出或PWM的输出
Ext Interrupt	INT0B	数字输入	外部中断0
	INT1B	数字输入	外部中断1
PWM	PWM0	数字输出	PWM0的输出
	PWM1	数字输出	PWM1的输出
	PWM2	数字输出	PWM2的输出
	PWM3	数字输出	PWM3的输出
	PWM4	数字输出	PWM4的输出
	PWM5	数字输出	PWM5的输出
ACMP	CMP2	模拟输入	比较器通道2的输入
ADC	AD6~12/ TK15	模拟输入	8通道ADC模拟输入
Touch Key	TK6~12/ TK15	模拟输入	8通道触摸按键输入
Key Board	KB0~7	模拟输入	8通道键盘输入
PORT0	P0.0~P0.5	数字输入输出	通用I/O P0端口
PORT1	P1.6	数字输入输出	通用I/O P1端口
PORT2	P2.0~P2.7	数字输入输出	通用I/O P2端口
ICP	PCL	数字输入	在线烧录模式下输入的时钟
	PDA	数字输入输出	在线烧录模式下输入输出的数据
DBW	DBW0A	数字输出	死区波形发生器DBW0A输出
	DBW1A	数字输出	死区波形发生器DBW1A输出
	DBW2A	数字输出	死区波形发生器DBW2A输出
	DBW0B	数字输出	死区波形发生器DBW0B输出
	DBW1B	数字输出	死区波形发生器DBW1B输出
	DBW2B	数字输出	死区波形发生器DBW2B输出
	DBW0IN	数字输入	死区波形发生器DBW0输入
	DBW1IN	数字输入	死区波形发生器DBW1输入
	DBW2IN	数字输入	死区波形发生器DBW2输入
BEEPER	BEEPER	数字输出	BEEPER输出

## 5 模块框图



## 6 极限参数

如果器件的工作条件超过所述“极限条件”的范围，将造成器件永久性破坏。只有当器件工作在说明书所规定的范围内时功能才能得到保障。器件工作在极限参数列举的条件下，将会影响到器件工作的可靠性。

参数	符号	值	单位
电源 VDD 供应电压	VDD	-0.3 to +3.6	V
电源 VCC 供应电压	VCC	-0.3 to +3.6	V
电源 VDDO 供应电压	VDDO	-0.3 to +2.5	V
端口输入电压	$V_{IN}$	-0.3 to (VDD+0.3)	V
工作温度	$T_{OP}$	-25 to +105	°C
存储温度	$T_{ST}$	-55 to +150	°C
VDD 最大电流	/	100	mA
VSS 最大电流	/	100	mA
每个 I/O 口的灌电流	/	10	mA
每个 I/O 口的输出电流	/	10	mA
所有 I/O 口的灌电流	/	100	mA
所有 I/O 口的输出电流	/	100	mA

## 7 电气特性

### 7.1 射频RF电气特性

(测试条件: VCC=+3V, VSS=0V, TA=-40°C to +105°C)

符合	参数 (测试条件)	注释	最小值	典型值	最大值	单位
	工作条件					
VCC	VCC 供电电压		2.4	3.3	3.6	V
T <sub>OP</sub>	工作温度		-25		105	°C
	常规射频条件					
f <sub>OP</sub>	工作频段		2402		2480	MHz
f <sub>XTAL</sub>	晶振频率			12		MHz
△f <sub>1M</sub>	频率偏移@1Mbps			280		KHz
R <sub>GFSK</sub>	数据传输速率			1		Mbps
F <sub>CHANNEL</sub>	信道间隔			1		MHz
	发射操作					
P <sub>RF</sub>	最大输出功率			0	5.5	dBm
P <sub>RFC</sub>	射频功率控制范围		18	20	22	dB
P <sub>RF1</sub>	第一临近信道发射功率				-20	dBm
P <sub>RF2</sub>	第二临近信道发射功率				-50	dBm
I <sub>VCC_H</sub>	高增益时功耗			16		mA
I <sub>VCC_L</sub>	低增益时功耗			12		mA
	接收操作					
I <sub>VCC</sub>	接收功耗			17		mA
RX <sub>SENS</sub>	0.1% BER 时接收灵敏度			-88		dBm

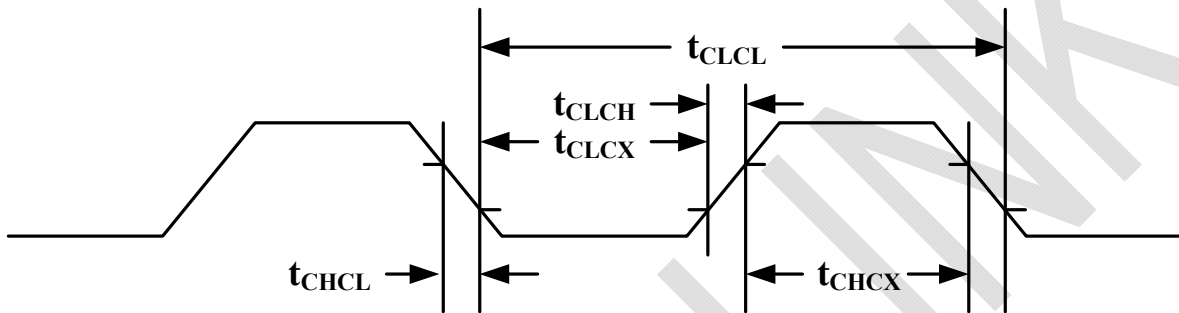
### 7.2 直流电气特性

(VDD = 2.4V~3.6V, T<sub>A</sub> = 25°C, 除非另有说明)

参数	符号	说明				测试条件
		最小值	典型值	最大值	单位	
工作电压	VDD	2.4	3.3	3.6	V	CPU core Freq: ~12MHz
工作电流	I <sub>OP</sub>		2		mA	No load, VDD=3.3V@8MHz
电源电流, 空闲模式	I <sub>IDLE</sub>		1		mA	No load, VDD=3.3V@8MHz, IDLE
电源电流, 停止模式	I <sub>STOP</sub>		5		uA	No load, VDD=3.3V, STOP
电源电流, 睡眠模式	I <sub>SLEEP</sub>		3		uA	No load, VDD=3.3V, SLEEP
输入高电压	V <sub>IH</sub>	0.7*VDD		VDD+0.2	V	
输入低电压	V <sub>IL</sub>	-0.5		0.3*VDD	V	
输出高电压	V <sub>OH</sub>	2.6			V	VDD=3.3V, I <sub>OH</sub> =-10mA
输出低电压	V <sub>OL</sub>			0.7	V	VDD=3.3V, I <sub>OL</sub> =+10mA

参数	符号	说明				测试条件
		最小值	典型值	最大值	单位	
端口上拉/下拉电阻	RPU		100		K $\Omega$	
POR 斜率	SPOR	0.025		4.5	V/ms	
POR 上升阈值电压	V <sub>PORH</sub>		1.6		V	
POR 下降阈值电压	V <sub>PORL</sub>		1.2		V	

## 7.3 交流电气特性



注：占空比为 50%。

### 7.3.1 外部时钟特性

(V<sub>DD</sub> = 2.4V~3.6V, T<sub>A</sub> = 25°C, 除非另有说明)

参数	符号	说明				测试条件
		最小值	典型值	最大值	单位	
时钟频率			12		MHz	
时钟高电平时间	t <sub>CHCX</sub>	30			ns	
时钟低电平时间	t <sub>CLCX</sub>	30			ns	
时钟上升时间	t <sub>CLCH</sub>			10	ns	
时钟下降时间	t <sub>CHCL</sub>			10	ns	

### 7.3.2 内部RC振荡特性

(V<sub>DD</sub> = 2.4V~3.6V, T<sub>A</sub> = 25°C, 除非另有说明)

参数	符号	说明				测试条件
		最小值	典型值	最大值	单位	
时钟频率			8/12		MHz	
时钟频率			±2		%	T <sub>A</sub> = 25°C

## 7.3.3 晶体振荡器/陶瓷振荡器特性

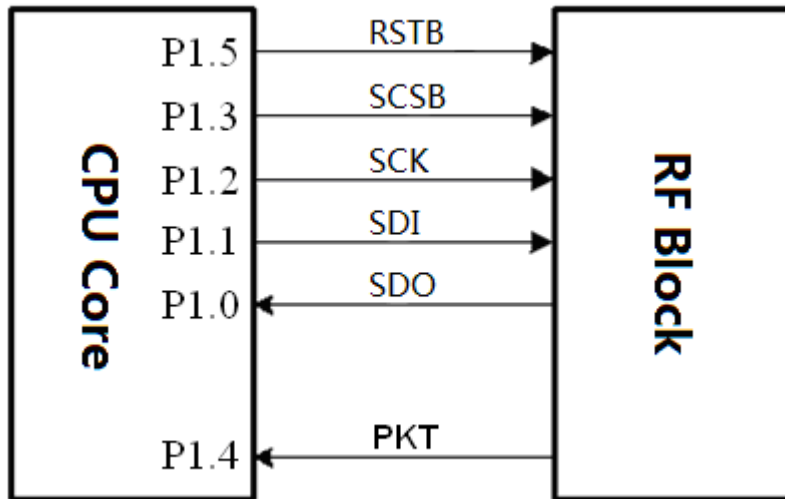
(VDD = 2.4V~3.6V, T<sub>A</sub> = 25°C, 除非另有说明)

参数	符号	说明				测试条件
		最小值	典型值	最大值	单位	
时钟频率		400K		12M	Hz	

## 8 内部RF接口

### 8.1 SPI接口说明

内部 RF 模块提供简单的 CPU 内核接口 SPI 模式，RF 模块的 SPI 接口只支持从模式。

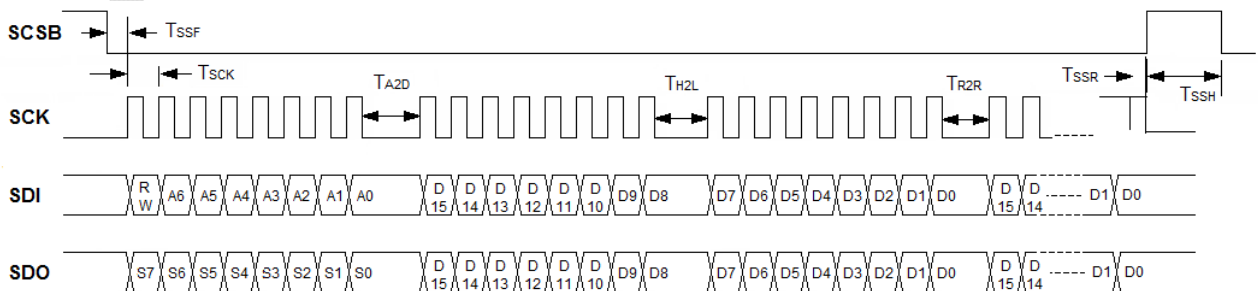


SPI 接口包含 7 个相关信号，如下表：

管脚	描述
RSTB	复位脚，低电平有效
SCSB	SPI接口从模式使能信号，低电平有效 从SLEEP模式唤醒芯片
SCK	SPI接口时钟输入
SDI	SPI接口数据输入
SDO	SPI接口数据输出
PKT	发射/接收包状态指示位

**注：**此时可配置 `rfspi_sft(code5.7)` 为 1，使用硬件 MCU-SPI 对接 RF。

### 8.2 SPI命令格式



符号	最小	典型	最大	描述
$T_{SSH}$	250ns			两次 SPI 命令时间间隔
$T_{SSF}, T_{SSR}$	41.5ns			SCSB 与 SCK 时间间隔
$T_{A2D}$	*1			地址与数据时间间隔
$T_{H2L}$	*1			高低字节数据时间间隔
$T_{R2R}$	*1			两个寄存器数据时间间隔
$T_{SCK}$	83ns			SCK 时钟周期

注：\*1—在读 FIFO 数据时，至少需要 450ns 等待时间；其它寄存器时  $T_{3min} = 41.5ns$ 。

## 9 存储器

内部存储器包含了 16K 字节 Flash 程序代码区、256 字节 EEPROM 数据代码区。

- 16K 字节程序 Flash
- 256 字节数据 EEPROM

### 9.1 存储器加密

器件内部对程序代码区进行了专有的高安全等级加密处理。

### 9.2 寄存器定义

#### 9.2.1 EEPROM控制寄存器—EECON

表 9-1 EECON寄存器 (97h)

位	符号	功能描述	类型	复位值
eecon.7	LOCK	<b>EEPROM编程禁止位</b> 0 – EEPROM编程被允许 1 – EEPROM编程被禁止	R/W	0
eecon.6~4	-	-	-	000
eecon.3	EPGM	<b>EEPROM编程中断允许位</b> 0: 中断被禁止 1: 当ea=1时, 中断被允许	R/W	0
eecon.2	PGMF	<b>EEPROM编程中断标志位</b> 1 – EEPROM编程结束, 发生中断信号 它只能由硬件置1, 可以被软件或中断清0, 当PGM =1 时会自动清除。	R/W	0
eecon.1	CPF	<b>EEPROM编程跨页标志位</b> 1 – EEPROM编程页地址发生更改 (跨页) 如果CPF=1, PGM不能被设置为1, 直到软件清除CPF。 CPF只能通过硬件置1。 如果发生跨页错误, 为避免对EEPROM的复位操作, 在CPF清除指令之后, 必须紧跟3个NOP指令。	R/W	0
eecon.0	PGM	<b>EEPROM编程允许位</b> 1 – EEPROM开始编程 写数据到EEPROM缓存之后, 设置PGM, 开始对EEPROM进行编程。如果没有写EEPROM缓存, 软件不能设置该位。当编程结束时, 它被硬件自动清除, 但是不能被软件清除。	R/TW	0



## 10 ICP (在线编程)

器件内部 Flash 与 EEPROM 的内容默认是空的,用户必须通过外部烧录器或在线烧录 ICP (In-Circuit Programming)工具对其编程。

在 ICP 工具中,用户一定要注意 ICP 编程引脚在系统板中的使用方法。在一些应用电路中,强烈建议用户:在 ICP 系统板上编程完成后,先断电、然后再上电。

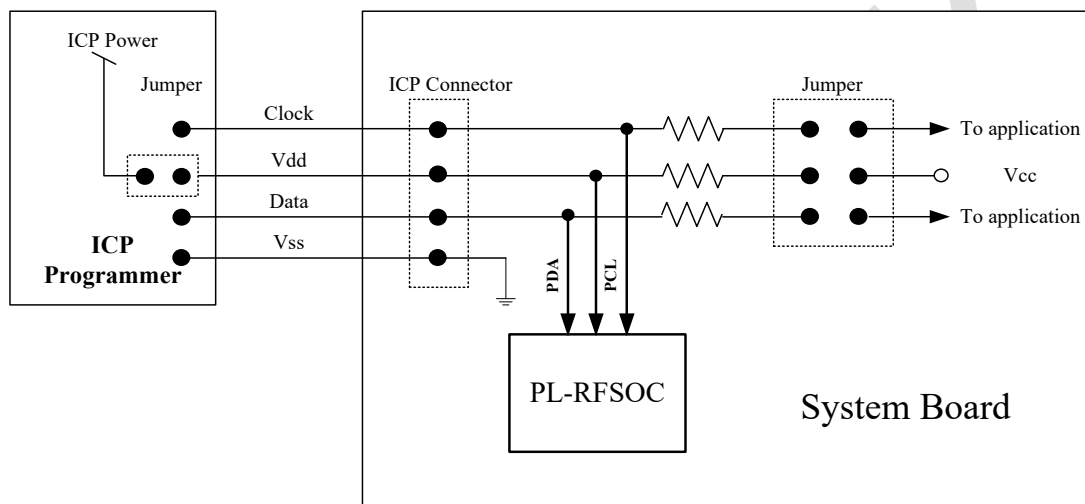


图 10-1 ICP应用电路

注:

1. ICP 操作期间,建议 ICP 和应用电路之间分开;
2. 电阻是可选的;
3. 当使用 ICP 升级代码时,时钟 PCL 和数据 PDA 必须连接到系统板内;
4. ICP 编程结束之后,建议:系统先断电,然后移除 ICP,接着在上电。

器件支持编程:应用程序区 Flash (4K 字节)、数据区 EEPROM (128 字节)。用户可以选择对程序区 Flash、数据区 EEPROM 其中之一编程,或对二者都编程。

## 11 ICD(在线调试)

芯片内部集成了ICD(In-Circuit Debugging)调试功能,允许控制CPU执行STOP停止/RUN运行/STEP步进等:

- 提供2线接口
- 可以有效地利用2线接口,同时进行测试和调试工作

ICD调试引脚PCL、PDA可通过使能配置位CODE1.7(ICDPEN);当CODE1.7为0时,禁用ICD调试引脚;当CODE1.7为1时,使能ICD调试引脚,此时PCL、PDA专用于ICD调试功能。

## 12 配置选项

以下配置选项用户可以在编程软件界面进行配置：

配置选项	配置选项
<b>程序区Flash锁定位</b> 0 – 锁定 1 – 解锁	<b>数据区EEPROM锁定位</b> 0 – 锁定 1 – 解锁
<b>Flash的ROM区使能位</b> 0 – 不固化成ROM 1 – 被固化成ROM	<b>Flash的ROM区大小选择位</b> 0 – 高4K为ROM区 1 – 高8K位ROM区
<b>RSTB复位管脚使能位</b> 0 – 禁止 1 – 使能	<b>ICD调试引脚使能位</b> 0 – 禁止 1 – 使能
<b>振荡器类型选择位</b> 00 – 内部高频RC振荡HIRC (4~12MHz) 01 – 内部低频RC振荡LIRC (32KHz) 10 – 晶振和陶瓷振荡器XTAL 11 – 外部时钟输入ECLK	<b>内部高频RC振荡频率选择位</b> 00 – 内部RC 4MHz 01 – 内部RC 8MHz 10 – 内部RC 12MHz 11 – RSV
<b>XTAL晶振内部阻容配置位</b> 0 – 不用15pf内部电容和内部反馈电阻 1 – 使用15pf内部电容和内部反馈电阻	<b>XTAL晶振驱动档位适配位</b> 000 – 200KHz 001 – 400KHz 010 – 2MHz 011 – 4MHz 100 – 8MHz 101 – 12MHz 110 – RSV 111 – RSV
<b>外部时钟ECLK配置字</b> 00 – LECK低功耗模式 (0MHz至0.5MHz) 01 – MECK中等功耗模式 (0.5MHz至4MHz) 10 – HECK高功耗模式 (4MHz至12MHz) 11 – HECK高功耗模式 (4MHz至12MHz)	
<b>热启动时间配置位</b> 00 – 最长 ..... 11 – 最短 注：不同振荡源Warmup档位不同	<b>超时Timeout配置位</b> 00 – (16ms+4次*4ms重试)*2-----64ms 01 – (16ms+4次*4ms重试)+16ms-----48ms 10 – (16ms+4次*4ms重试)+8ms-----40ms 11 – (16ms+4次*4ms重试)+0.125ms----32ms
<b>看门狗WDT使能位</b> 0x – 禁止 10 – 允许, 由WDTEN控制 11 – 允许, 由WDTEN控制, 停止模式中被禁止	<b>WDT使能位上电默认状态配置位</b> 0 – 默认未开启WDT 1 – 默认开启WDT (看门狗WDT配置为使能时)
<b>低电压复位LVR使能位</b> 00 – 禁止 01 – RSV 10 – 允许 (使用SLEEP模式时需开启) 11 – RSV	<b>低电压检测LPD使能位</b> 0 – 禁止 1 – 允许
<b>低电压复位LVR阈值电压选择位</b> 000 – 1.2v 001 – 1.5v 010 – 1.8v	<b>低电压检测LPD阈值电压选择位</b> 000 – 1.2v 001 – 1.5v 010 – 1.8v

配置选项	配置选项
011 – 2.1v 100 – 2.4v 101 – 2.7v 110 – 3.7v 111 – 4.3v	011 – 2.1v 100 – 2.4v 101 – 2.7v 110 – 3.7v 111 – 4.3v
外部中断触发补充模式释放模式选择位 0 – 由IFx释放 1 – 由intxack释放	
外部中断0触发补充模式选择位 00 – 默认模式，受控于it0 & it0_inv 01 – 上升沿触发（内部低电平触发） 10 – 下降沿触发（内部低电平触发） 11 – 双沿口触发（内部低电平触发）	外部中断1触发补充模式选择位 00 – 默认模式，受控于it1 & it1_inv 01 – 上升沿触发（内部低电平触发） 10 – 下降沿触发（内部低电平触发） 11 – 双沿口触发（内部低电平触发）

## 13 MCU核详细说明

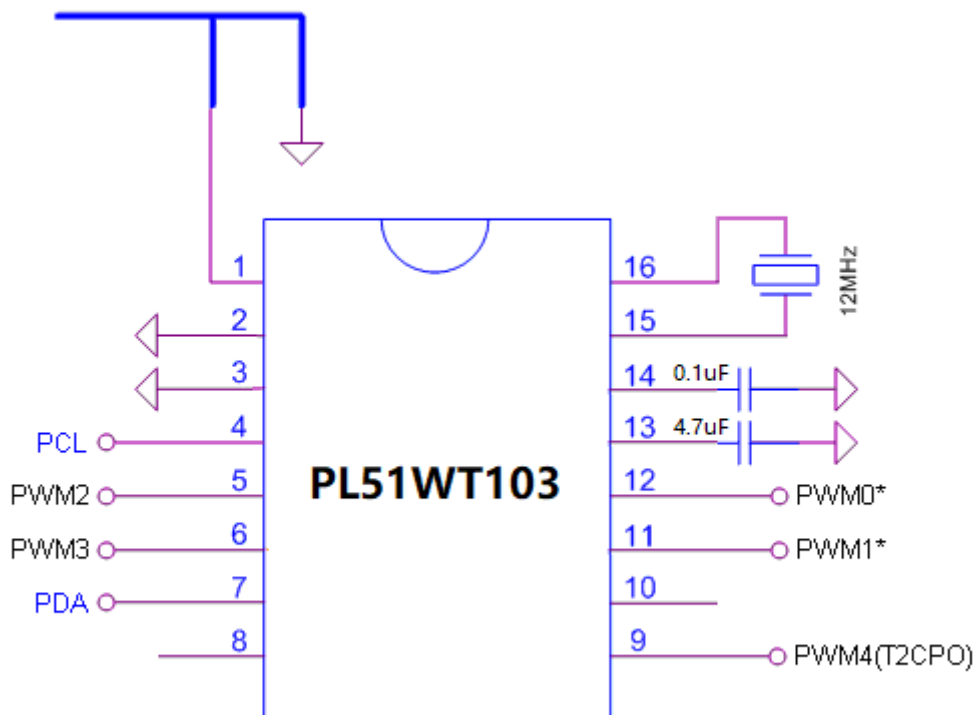
MCU 核详细描述参见《用户手册》，请联系聚元微索取。

## 14 RF模块控制寄存器

最新的推荐控制寄存器值参考《用户手册》，请联系聚元微索取。

## 15 典型应用

### 15.1 智能照明：RGB七彩+冷暖双色

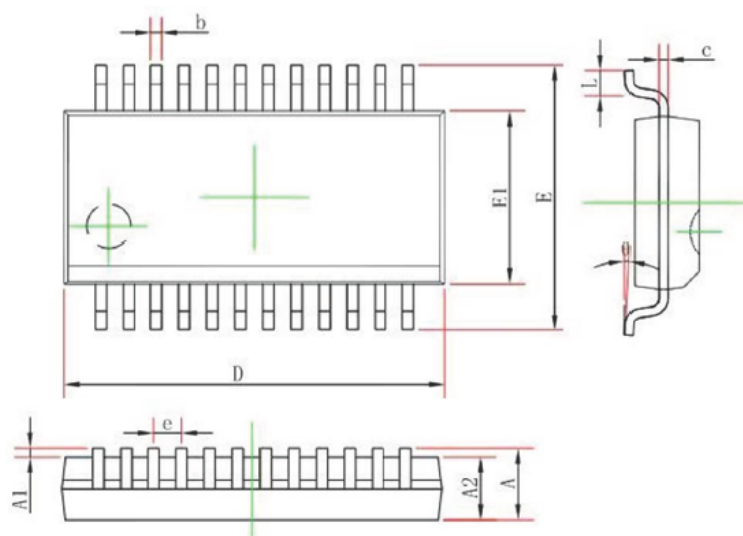


注：SOP16 的 PWM 为 4(12 位)+1(8 位)；使用 TSSOP20/SSOP24 时支持的 PWM 为 6(12 位)+1(8 位)，可以实现如“RGB+冷暖双色+分层灯”等更好的功能与效果。

## 16 封装尺寸

### 16.1 SSOP24 封装

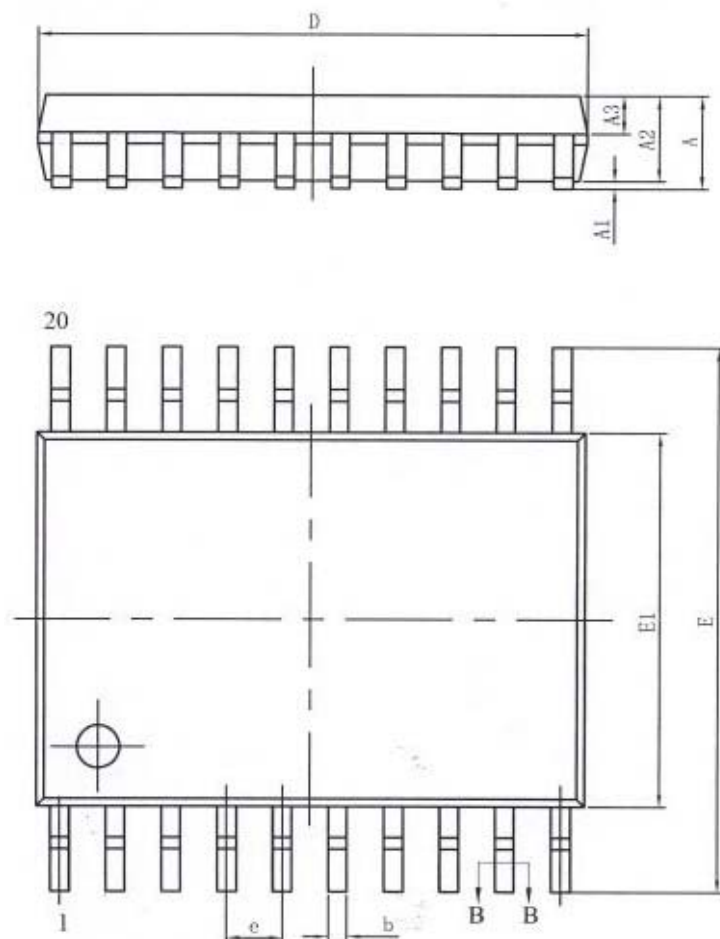
SSOP24 封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	—	1.750
A1	0.050	0.080
A2	1.400	1.500
b	0.203	0.305
c	0.102	0.254
D	8.550	8.650
E1	3.800	4.000
E	5.800	6.200
e	0.635 (BSC)	
L	0.400	1.270
θ	0°	8°

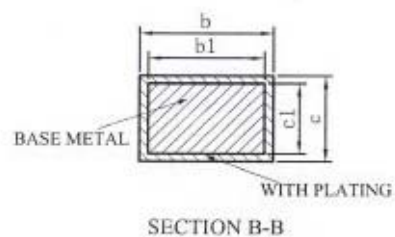
## 16.2 TSSOP20 封装

### TSSOP20 封装尺寸



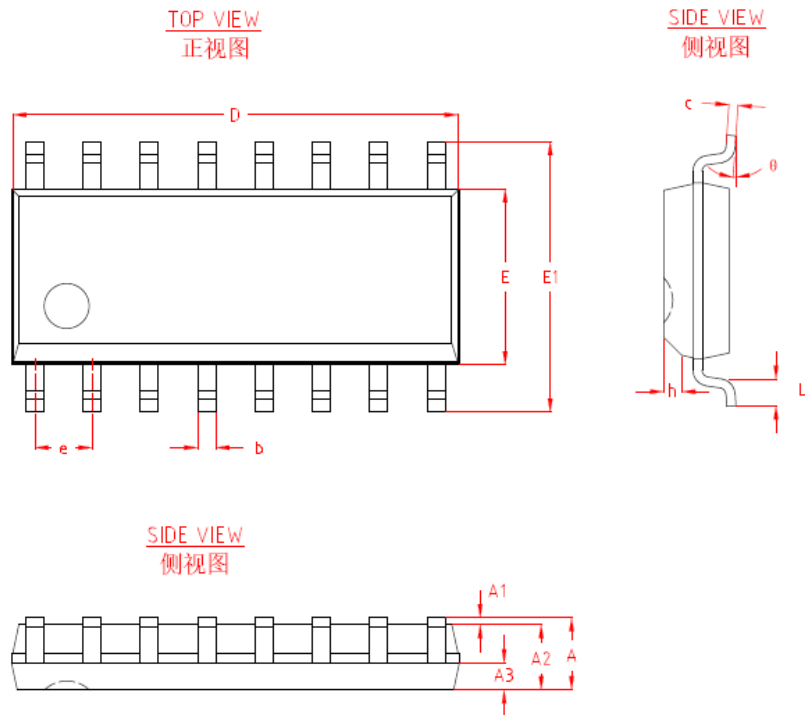
TSSOP20L

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.20
A1	0.05	—	0.15
A2	0.80	1.00	1.05
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	—	0.29
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.13	—	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	6.40	6.50	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
E	6.20	6.40	6.60
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00BSC		
$\theta$	0	—	8°



## 16.3 SOP16 封装

### SOP16 封装尺寸



机械尺寸/mm Dimensions			
字符 SYMBOL	最小值 MIN	典型值 NOMINAL	最大值 MAX
A	-	-	1.75
A1	0.10	-	0.25
A2	1.35	1.45	1.55
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.35	-	0.50
c	0.19	-	0.25
D	9.80	10.00	10.20
E	3.80	3.90	4.00
E1	5.80	6.00	6.20
e	1.27 BSC		
h	0.30	-	0.50
L	0.40	-	0.80
θ	0°	-	8°



## 17 订购信息

产品型号代码	封装形式
PL51WT103S16	SOP16, Tube
PL51WT103S16R	SOP16, Tape&Reel
PL51WT103T20	TSSOP20, Tube
PL51WT103B24	SSOP24, Tube
.....	.....

注：以上订购信息中产品型号代码未详尽，仅是举例说明。产品表面丝印仅标注主要信息，根据封装形式不同与产品型号代码会有差异，具体请联系聚元微。

## 18 文档修改记录

Rev.	Date	Comments
0.1	2021/07/28	初始版本
0.2	2021/08/06	优化管脚定义
0.3	2021/09/06	优化 SSOP24 管脚定义
0.4	2021/09/29	加入寄存器 AUXCON.s003_sopt 使用注意
0.5	2021/11/04	更新工作参数
0.6	2022/07/22	移除 DAC/OPA 管脚
0.7	2023/02/06	更新 PL51T103 管脚定义，移除 TKADC-5&13&14

## 19 注意事项

为了持续改进产品的可靠性、功能或设计，聚元微保留随时更新修改的权利，并不另行通知客户。客户在下单前请确认所使用的是最新的完整版说明书。